

群联称 NAND 原厂或将在 12 月减产，三星电子扩建 HBM 等半导体封装工厂

——存储芯片周度跟踪（2024.11.11-2024.11.15）

■ 核心观点

NAND: NAND 颗粒市场价格小幅波动，群联称 NAND 原厂或将在 12 月减产。根据 DRAMexchange，上周（1111-1115）NAND 颗粒 22 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.62%至 1.54%，平均涨跌幅为-0.08%。其中 11 个料号价格持平，3 个料号价格上涨，8 个料号价格下跌。根据 CFM 闪存市场报道，群联电子潘健成指出，NAND 原厂很可能将在 12 月减产，推动 2025 年下半重回供应紧缺的局面。A 市场需求未来将会延伸到消费者及企业用市场，将是群联布局的强项，对于 2025 年的 NAND Flash 市场前景仍抱持正面看待。

DRAM: 颗粒价格小幅下跌，ASML 称 2025-2030 年间高级逻辑和 DRAM 的 EUV 光刻支出复合年增长率将达两位数。根据 DRAMexchange，上周（1111-1115）DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.95%至 1.52%，平均涨跌幅为-0.92%。上周 2 个料号呈上涨趋势，16 个料号呈下降趋势，0 个料号价格持平。根据 CFM 闪存市场报道，ASML 认为，EUV 技术持续具有成本效益的可扩展性，预计将使客户能够将多图案层进一步转移到单图案 EUV 0.33 NA 和 EUV 0.55 NA，适用于高级逻辑和 DRAM。因此，ASML 预计，2025 年至 2030 年间，高级逻辑和 DRAM 的 EUV 光刻支出复合年增长率将达到两位数。

HBM: 三星电子扩建 HBM 等半导体封装工厂。根据 CFM 闪存市场报道，三星电子与韩国忠清南道签署协议，将扩大其天安第 3 工业区的半导体封装工厂，三星电子将从下个月到 2027 年 12 月的三年内，在天安第三综合工业园区三星显示器的 28 万平方米场地上安装半导体封装加工设施，以生产高带宽存储器（HBM），建设韩国先进、规模化的半导体封装工艺设施。三星电子将能够通过天安半导体封装工艺工厂生产 HBM 来确保在全球尖端半导体市场的领导地位。

市场端: 渠道及行业市场价格短暂持平。上周（1111-1115）eMMC 价格环比下跌，UFS 价格环比下跌。根据 CFM 闪存市场报道，随着部分资源供应增加，主控 Turn-Key 方案加持，加之客户价格预期低、部分存储厂商为追逐业绩降价促销激进，本周大容量嵌入式产品价格再度延续跌势。渠道市场层面，近期个别存储厂商现杀价动作，但影响较为有限；整体市场无明显波动，本周渠道及行业市场价格短暂持平。

■ 投资建议

我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。

HBM: 受益于算力芯片提振 HBM 需求，相关产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

存储芯片: 受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

■ 风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子

日期： 2024年11月18日

分析师： 陈宇哲

E-mail: chenyzhe@yongxingsec.com

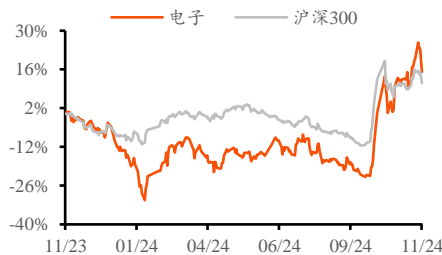
SAC编号: S1760523050001

联系人： 林致

E-mail: linzhi@yongxingsec.com

SAC编号: S1760123070001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告:

《SK 海力士 16 层 48GB HBM3E 将于 2025 年初送样，渠道市场价格小幅下修》

——2024 年 11 月 13 日

《三星电子计划生产 400 层堆叠 NAND，渠道市场短暂止跌》

——2024 年 11 月 10 日

《渠道仍处于下行通道，三星持续推进 HBM4》

——2024 年 11 月 02 日

正文目录

1. 存储芯片周度价格跟踪	3
2. 行业新闻	4
3. 公司动态	6
4. 公司公告	7
5. 风险提示	8

图目录

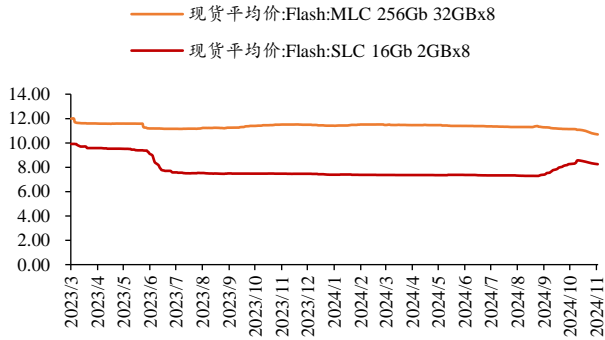
图 1: NAND 中大容量现货价格 (美元)	3
图 2: NAND 中小容量现货价格 (美元)	3
图 3: NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)	3
图 4: NAND Wafer 中小容量现货价格 (美元)	3
图 5: DRAM 中大容量现货价格 (美元)	3
图 6: DRAM 中小容量现货价格 (美元)	3

表目录

表 1: 存储行业本周重点公告 (11.11-11.15)	7
-------------------------------------	---

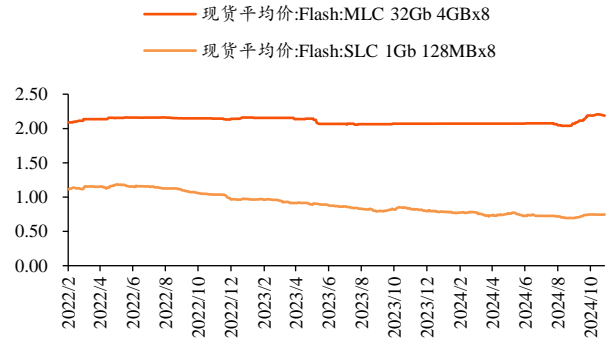
1. 存储芯片周度价格跟踪

图1:NAND 中大容量现货价格 (美元)



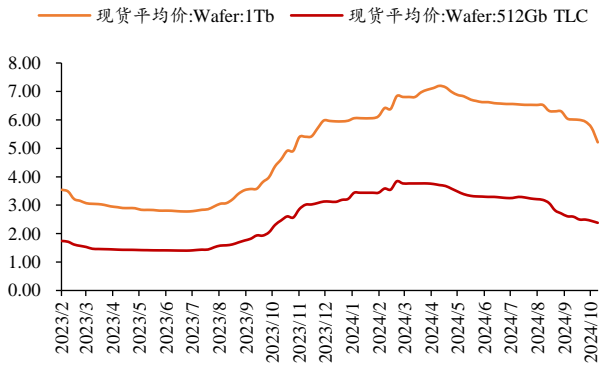
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图2:NAND 中小容量现货价格 (美元)



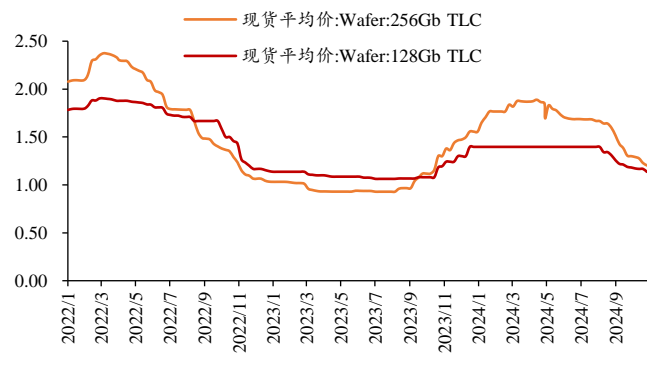
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图3:NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)



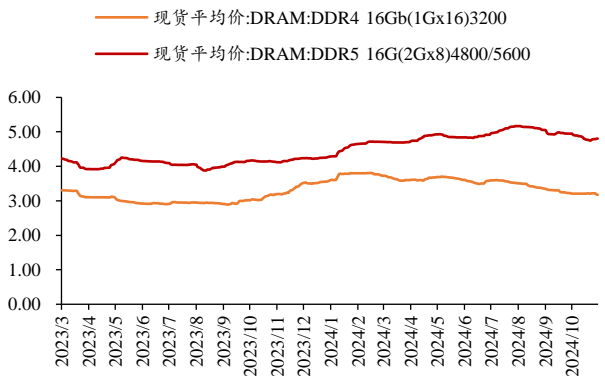
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图4:NAND Wafer 中小容量现货价格 (美元)



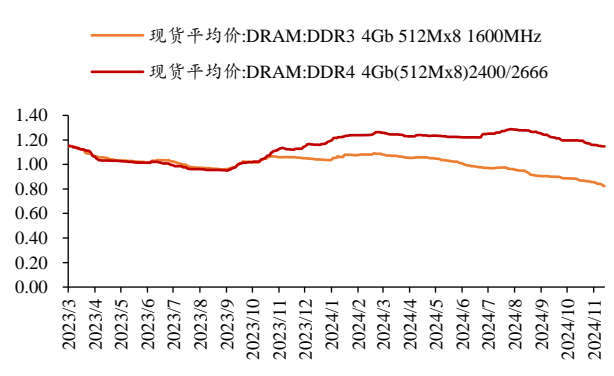
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图5:DRAM 中大容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图6:DRAM 中小容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

2. 行业新闻

渠道低价资源现短缺问题，然存储行情仍处于震荡磨底期，PC 终端担忧 Q4 面临“旺季不旺”

11 月 12 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，随着部分资源供应增加，主控 Turn-Key 方案加持，加之客户价格预期低、部分存储厂商为追逐业绩降价促销激进，本周大容量嵌入式产品价格再度延续跌势。渠道市场层面，近期个别存储厂商现杀价动作，但影响较为有限；整体市场无明显波动，本周渠道及行业市场价格短暂持平。下半年以来，存储品牌厂商普遍业绩压力逐渐凸显，除国内多家存储厂商 Q3 净利润均环比跌幅明显，近日台湾地区存储厂商也并不“好过”，从 10 月业绩来看，多家厂商单月营收逊于 2023 年同期水平，已连续两个月营收同比下滑，市场悲观情绪弥漫，群联电子 CEO 潘健成更是预估 NAND 原厂很可能将在 2024 年 12 月减产，推动 2025 年下半年重回供应紧缺的局面。不过目前部分原厂还未明确“出牌”，供需双方均在耐心观望市场变化。PC 终端方面，近期华硕、宏碁等 PC 品牌厂商最新业绩出现熄火，10 月营收环比跌幅将近 2-3 成，创近一个季度新低；虽 2024 年以来 PC OEM 积极大力推出 AI PC 产品，但 2024 年以来实际 AIPC 出货量渗透率仍然较低，对 PC 品牌厂商整体业绩贡献较为有限；而对于后市，部分 PC OEM 厂商预计四季度 PC 市场整体需求不明朗，或将面临“旺季不旺”。

资料来源：(CFM 闪存市场)

ASML：2025-2030 年间高级逻辑和 DRAM 的 EUV 光刻支出复合年增长率将达两位数

11 月 14 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，ASML 认为人工智能的出现为半导体行业创造了重大机遇，因为人工智能有可能成为整个社会生产力和创新的下一个巨大驱动力。预计这些发展将有助于推动全球半导体销售额在 2030 年超过 1 万亿美元，这意味着 2025-2030 年期间半导体市场的年增长率约为 9%。此外，ASML 认为，在本世纪剩余时间内，增加 EUV 曝光次数的机会很大。EUV 技术持续具有成本效益的可扩展性，预计将使客户能够将多图案层进一步转移到单图案 EUV 0.33 NA 和 EUV 0.55 NA，适用于高级逻辑和 DRAM。因此，ASML 预计，2025 年至 2030 年间，高级逻辑和 DRAM 的 EUV 光刻支出复合年增长率将达到两位数。

资料来源：(CFM 闪存市场)

三星电子扩建 HBM 等半导体封装工厂

11 月 12 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，三星电子与韩国忠清南道签署协议，将扩大其天安第 3 工业园区的半导体封装工厂，三星电子将从

下个月到 2027 年 12 月的三年内，在天安第三综合工业园区三星显示器的 28 万平方米场地上安装半导体封装加工设施，以生产高带宽存储器（HBM），建设韩国先进、规模化的半导体封装工艺设施。三星电子将能够通过天安半导体封装工艺工厂生产 HBM 来确保在全球尖端半导体市场的领导地位。

资料来源：(CFM 闪存市场)

群联潘健成：NAND 原厂或将在 12 月减产

11 月 11 日消息，根据 CFM 闪存市场报道，群联电子执行长潘健成表示，9 月客户接单量为 2024 年以来低点，包括双十一、圣诞节促销均未看到备货需求，市场通膨严重影响了消费者采购能力。但企业级存储、工业及车用产品需求稳健，及部分存货提列回冲，将有利于 10 月毛利率改善。10 月的接单量则受惠于企业级存储带动，接单总量成长了 20%，近期 11 月也持续观察到游戏、PC 及高阶产品的急单挹注。此外，潘健成指出，NAND 原厂很可能将在 12 月减产，推动 2025 年下半年重回供应紧缺的局面。A 市场需求未来将会延伸到消费者及企业用市场，将是群联布局的强项，对于 2025 年的 NAND Flash 市场前景仍抱持正面看待。

资料来源：(CFM 闪存市场)

3. 公司动态

【东芯股份】公司聚焦各行业的头部客户，同时持续开拓新市场、导入新客户，不断优化产品与客户结构

11月14日，东芯股份在投资者互动平台表示，公司聚焦中小容量的NAND Flash、NOR Flash、DRAM产品的研发、设计与销售，产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。公司聚焦各行业的头部客户，同时持续开拓新市场、导入新客户，不断优化产品与客户结构，努力提高公司产品的市场占有率。

资料来源：（投资者互动平台）

【联瑞新材】公司紧抓行业发展机遇，高阶产品结构占比进一步提高，经营质量持续提升，整体保持较为良好的经营态势

11月11日，联瑞新材在投资者互动平台表示，2024年以来，半导体市场整体需求逐渐回暖，并且AI、HPC等领域的快速发展，带来了高端封装材料旺盛的市场需求，公司紧抓行业发展机遇，高阶产品结构占比进一步提高，经营质量持续提升，整体保持较为良好的经营态势，球形产品产能利用率进一步提高。公司40年来始终专注于先进功能性无机粉体材料领域，产品从最开始的角形产品发展到微米级、亚微米级、Low α 、LowDF球形产品等多个序列，并从硅基氧化物拓展至铝基氧化铝、氮化物、二氧化钛、浆料等，形成了多序列多品类的产品布局，公司各类产品均有同行竞争，在先进产品领域与海外同行交叉较多。

资料来源：（投资者互动平台）

4. 公司公告

表1: 存储行业本周重点公告 (11.11-11.15)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/11/14	大为股份	股份回购进展	截至本公告日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后, 公司总股本由237,250,000股减至237,155,000股。
2024/11/15	华城海科	对外投资	公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益(具体以现金管理产品赎回金额为准)和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司(以下简称“华威电子”、“交易标的”或“标的公司”)30%股权(对应标的公司认缴出资额2,597.7260万元), 交易价格为4.8亿元。

资料来源: IFind, 甬兴证券研究所

5. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。